산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 2월 25일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 2. 25.(목) 오전 10시 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 2. 24.(수)	담당부서	산업부 반도체디스플레이과 중기부 미래산업전략팀 금융위 산업금융과
담당과장	조익노 과장(044-203-4270) 이두연 팀장(042-481-3913) 선 욱 과장(02-2100-2860)	담 당 자	박성수 사무관(044-203-4274) 허창기 사무관(042-481-3918) 이영민 사무관(02-2100-2865)

민간투자 · 금융지원으로 시스템반도체 성장을 견인한다.

- 시스템반도체 133조원 투자, 반도체 클러스터 등 대규모 프로젝트 지원 -
- 총 6,500억원 규모의 펀드 조성으로 반도체 생태계 육성 -
- 시스템반도체 등 BIG3 분야 우대금리 · 특례보증 제공 -

□ 정부는 2월 25일 제5차 혁신성장 BIG3 추진회의(주재 : 경제부총리)를 개최하고, 시스템반도체 산업의 지속적인 성장 생태계 조성을 위한 **「시스템반도체 분야 민간투자 실행 가속화 및 투자·보증 강화 방안」**을 발표하였다.

○ 同 방안을 통해 정부는 국내 반도체 제조 인프라 확대를 위해 **대규모 민간투자의 차질없는 이행을 지원**하고 다양한 **펀드 및 정책금융 프로그램을 활용**하여 **시스템반도체 경쟁력을 제고**해 나갈 계획이다.

□ 먼저, 국내 주요기업의 **대규모 민간투자 프로젝트**와 관련된 **행정절차 이행, 규제 완화 등을 조속히 추진**하여, **변화하는 반도체 시장에 적기 대응**할 수 있도록 지원한다.

○ 이를 위해, 현재 추진 중인 ①**시스템반도체 133조원 투자**, ②**용인 반도체 클러스터 조성** 등 대규모 민간투자 **추진 과정에서 발생하는 애로사항**은 관계부처간 협의*를 통해 **조기에 해소**하고,

* 기업의 투자 애로 접수(산업부) → 관계부처간 애로 해소 협의 → 정부 협의체 상정·의결

○ **최근 소부장 특화단지로 지정된 용인 반도체 클러스터**는 올해 **연말까지 착공**할 수 있도록 관련 절차*를 조속히 이행할 예정이며, 향후 **기반시설**(용수, 전력 등)**의 적기 구축**을 지원한다.

* 수도권정비위원회 심의·의결(~3월 1주) → 산단계획 승인('21.3월중) → 산단 공사 착공('21.4분기) → 1단계 Fab 착공('23년) → 산단 조성 및 1단계 Fab 완공('25년초)

용인 반도체 클러스터 개요

○ **(사업비)** 총 120조원 (장비구매 등 포함), 산단 조성비 1.8조

○ **(사업기간)** '19~'25년 ('21.4Q 산단 공사 착공)

○ **(내용)** ①반도체 4개 Fab 신설, 최대 80만/월 생산능력 확보
②50개 이상 협력업체가 입주하는 상생형 클러스터 조성
③스마트산단 적용 및 창업활성화 등 혁신활동 지원

○ **(기대효과)** 1.7만명 신규 직접고용



□ 아울러, 시스템반도체 기업의 경쟁력 제고를 위해 민간을 중심으로 조성된 **총 6,500억원의 펀드를 활용**하고, **이 중 2,800억원은** 기존 펀드의 **후속펀드 및 신규펀드로 마련**한다.

* (팹리스) 반도체 제조시설 없이 SoC 설계·개발을 수행하는 설계 전문기업
(디자인하우스) 설계된 회로를 파운드리에서 생산 가능하도록 최적화 서비스를 제공하는 기업

❶ **시스템반도체 상생펀드**(총 1,000억원)는 연내 400~500억원을 투자하고, 올해 500억원 규모의 하위펀드를 조성할 계획이다.

❷ **반도체성장펀드**(총 2,000억원)는 하위펀드로 약 300억원 규모의 M&A 프로젝트 펀드를 신규 조성한다.

❸ 또한, 지난해 1,500억원 규모로 마련된 **D.N.A+BIG3 펀드**는 올해 1,000억원 규모의 후속펀드를 조성하여 **총 2,500억원의 투자재원을 확보**할 예정이며,

❹ 반도체 산업의 소재·부품·장비 분야 중견·중소기업을 중점 육성하기 위해 ④**총 1,000억원 규모의 소부장 반도체 펀드도 연내 신설**한다.

< 시스템반도체 분야에 투자 가능한 대표 민간펀드 >

분야	규모	'21년 주요계획
시스템반도체 상생펀드	1,000억원	▸400~500억원 투자 추진, 500억원 규모의 하위펀드 조성
반도체성장펀드	2,000억원	▸약 300억원 규모의 M&A 프로젝트 펀드 조성
D.N.A+BIG3 펀드	2,500억원	▸1,000억원 규모의 후속펀드 추가 조성
소부장 반도체 펀드	1,000억원	▸연내 신규 조성 예정

□ 마지막으로, **정책자금 대출** 및 **정책보증 프로그램**을 활용하여 시스템반도체 기업의 **신규 투자를 활성화**하고, 민간기업의 **자생적인 성장 기반 조성**을 지원한다.

○ 산업 경쟁력 강화를 위해 마련된 **산업은행, 기업은행** 등의 **정책자금***을 활용하여 **중견·중소기업의 신규투자를 촉진**한다.

* ('21년 지원규모) ▲산업구조 고도화 프로그램 : 3조원, ▲대한민국 대전환 뉴딜 특별자금 : 3.5조원

< 시스템반도체 분야에 지원 가능한 대표 프로그램 >

구분		주요내용
산업구조 고도화 프로그램 (산은, 기은)	지원 분야	▸**(중견·중소기업 투자)** 주력산업* 경쟁력 제고 및 신산업 창출·확산 등에 필요한 설비·기술투자 * 소재·부품·장비, 반도체·디스플레이·배터리, 자동차·조선, 섬유·가전, 석유화학 등 ▸**(대중소 상생투자)** 협력업체 설비투자·기술개발 및 밸류체인 단위투자 ▸**(사업재편)** 사업구조 개선 및 신시장 진출·사업장 이전
	지원 조건	▸**(지원한도)** [산은] (시설자금) 최대 2,500억원, (운영자금) 최대 300억원 [기은] (시설자금) 최대 250억원, (운영자금) 최대 30억원 ▸**(여신기간)** [산은] (시설자금) 10년 이내, (운영자금) 3년 이내 [기은] (시설자금) 15년 이내, (운영자금) 5년 이내 ▸**(금리우대)** 0.5~0.7%p 감면
대한민국 대전환 뉴딜 특별자금 (산은)	지원 분야	▸**뉴딜투자 공동기준 분야* 및 품목 영위 기업, 정부 추진 뉴딜사업 참여 기업** * 뉴딜투자 공동기준 : 시스템반도체, AI 칩 등 차세대 반도체 포함 총 40개 분야
	지원 조건	▸**(여신기간)** [시설자금] 최대 20년, [운영자금] 3년 이내 ▸**(금리우대)** 최대 중소·중견 0.8%p 대기업 0.2%p 감면

○ **기술보증기금**의 4차 산업혁명 프로그램 운영 시 **D.N.A+BIG3 분야 기업**은 핵심기업으로 분류하여 **우대 조건*을 제공**하고, 보증한도 심사 시 **新기술평가시스템**을 활용**하여 맞춤형으로 지원한다.

* ①보증료 0.3%p 감면, ②보증 비율 95% 적용, ③운전자금 사정 생략(~2억원)
** 분야별 영위업종 변수 분석에 AI 접목 / 기술 차별성, 모방 난이도 등 미래 성장 지표에 가중치 부여

○ 이와 함께, **신용보증기금**에서도 ①**뉴딜기업 특화보증***, ②**소부장 협력모델 특례보증****** 등 보증한도 특례 프로그램을 활용하여 시스템반도체 기업을 적극적으로 지원할 계획이다.

* (뉴딜기업 특화보증) 보증료율 최대 △0.4%p 및 보증비율 최대 95% 지원
** (소부장 협력모델 특례보증) 보증료율 최대 △0.3%p 및 보증비율 최대 90% 지원

□ 박진규 산업부 차관은 "시스템반도체가 진정한 성장궤도에 안착하기 위해서는 **활발한 민간투자**가 바탕이 되는 **자생적 생태계 조성**이 반드시 필요하며, 이번에 **대규모 금융이 반도체 생태계 전반에 공급**되면 시스템반도체 기업의 **창업과 스케일업을 촉진**할 것으로 기대된다."면서,

○ "업계 및 관계부처와 협력을 통해 **민간투자 애로사항을 신속하게 해소**하고, 우리 기업이 **정책금융과 민간펀드를 적극적으로 활용**하여 **다양한 신규 투자**가 추진될 수 있도록 지원해 나가겠다."고 언급하였다.

【붙 임】「시스템반도체 분야 민간투자 실행 가속화 및 투자·보증 강화 방안」

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 박성수 사무관(☎ 044-203-4274)에게 연락주시기 바랍니다.